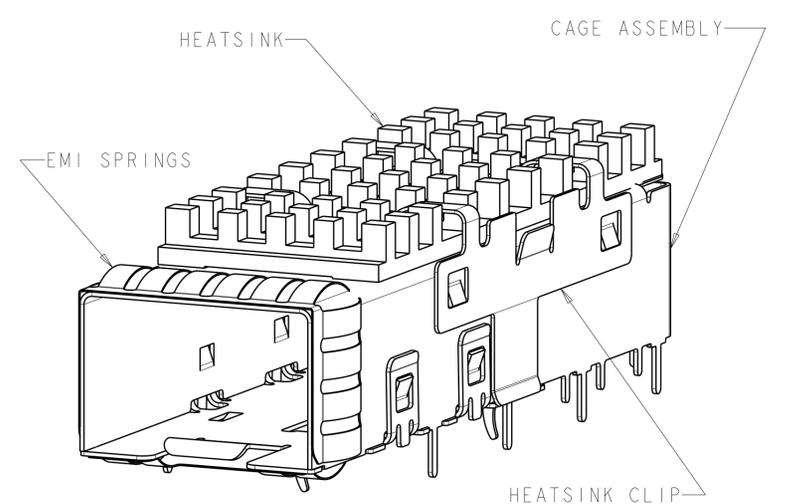
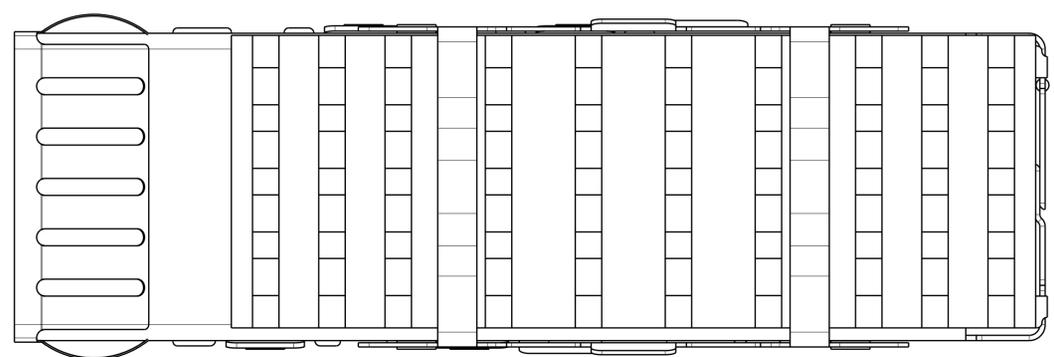
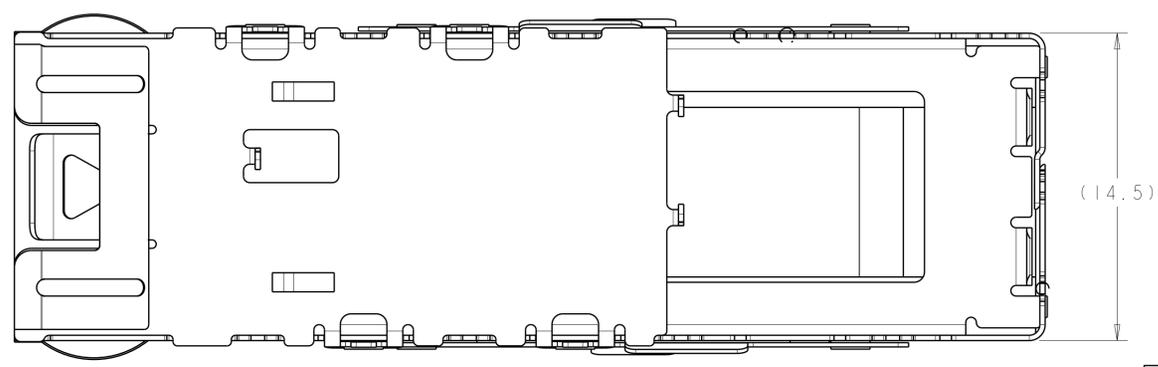
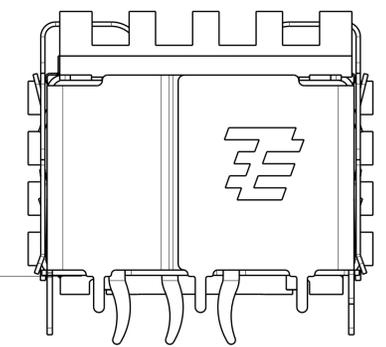
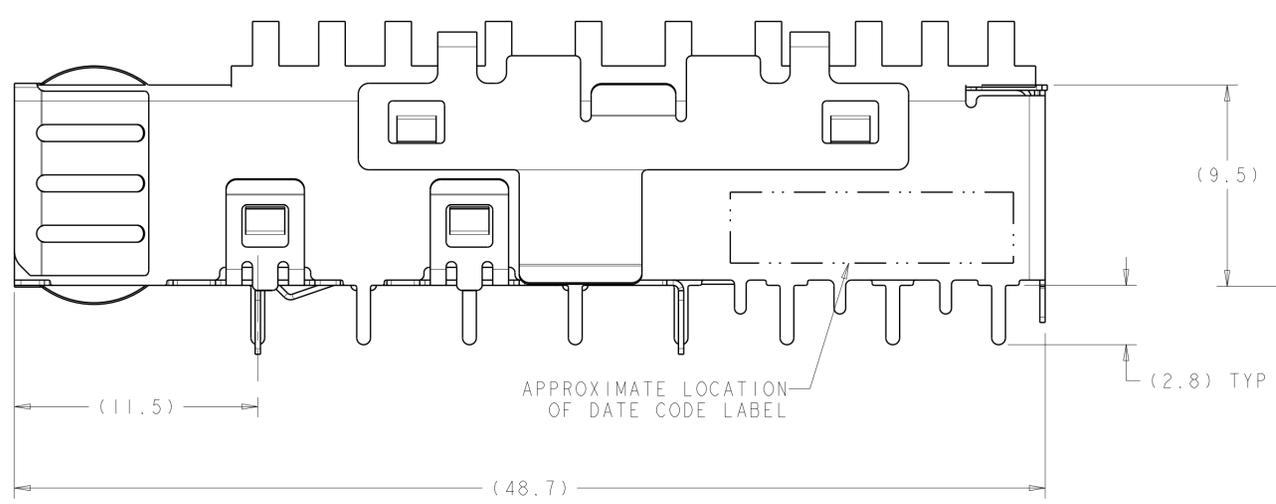
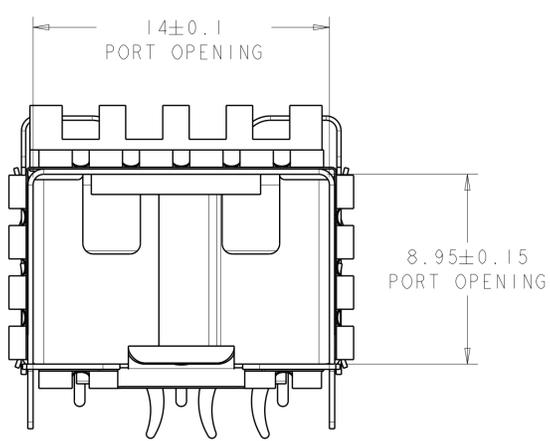


LOC	DIST	REVISIONS			
GP	00	REV	DATE	BY	APPD
		C	200CT2009	CR	MS
		D	26FEB2010	CJV	MRS
		E	05JAN2012	TX	AC

- 1 MATERIAL:  
 CAGE ASSEMBLY - NICKEL-SILVER ALLOY.  
 EMI SPRINGS - COPPER ALLOY.  
 HEATSINK - ALUMINUM ALLOY.  
 HEATSINK CLIP - STAINLESS STEEL.
- 2 FINISH:  
 HEATSINK - ELECTROLESS NICKEL.  
 HEATSINK CLIP - PASSIVATE.  
 EMI SPRINGS - 0.8µm MIN MATTE TIN OVER 0.8µm MIN NICKEL.  
 NON PLATED EDGES PERMISSIBLE.
- 3. MATES WITH SFP MSA COMPLIANT TRANSCEIVERS.
- 4 PADS AND VIAS CHASSIS GROUND.
- 5 DATUMS AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 6. MINIMUM PC BOARD THICKNESS:  
 SINGLE SIDED = 1.50mm
- 7 DIMENSIONS APPLIES PRIOR TO INSERTION OF SFP MODULE.
- 8. CAGE ASSEMBLY, HEATSINK CLIP AND HEATSINK SHIPPED ASSEMBLED.
- 9. NOTE DELETED



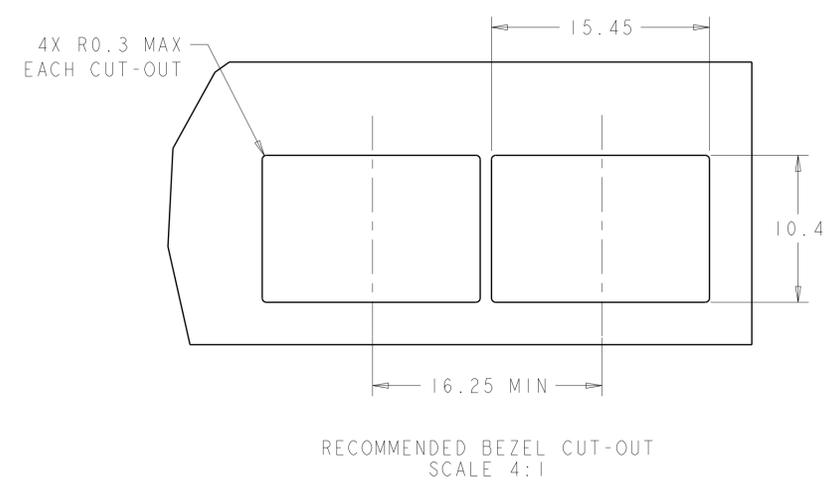
2007193-1  
 SCALE 5:1



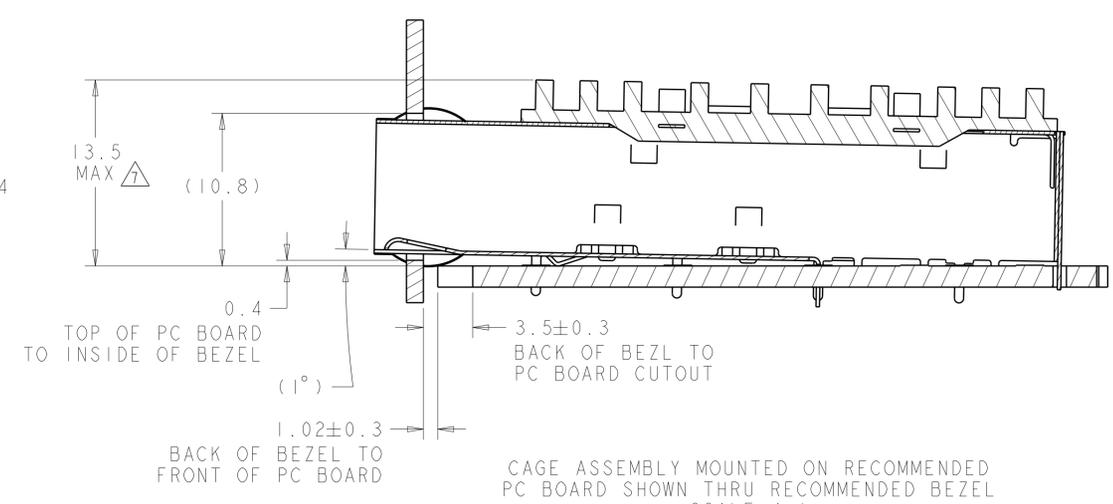
2007193-1  
 PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN Z. M. BEAM 10JUL2007	TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK M. R. SCHMITT 10JUL2007	NAME SFP+ 1X1 CAGE ASSY W/ HEATSINK PCI SOLDER TAILS EXTERNAL EMI SPRING FINGERS	
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APPD P. H. WERTZ 10JUL2007	PRODUCT SPEC 108-2364	
Ø	9 PLC ±0.1	PRODUCT SPEC	APPLICATION SPEC	
	1 PLC ±0.1	SIZE	114-13120	
	2 PLC ±0.1	WEIGHT	A100779C=2007193	
	3 PLC ±0.05	CUSTOMER DRAWING	SCALE 6:1 SHEET 1 OF 2 REV E	
	4 PLC ±0.05			
	ANGLES ±0.05			
MATERIAL	FINISH			

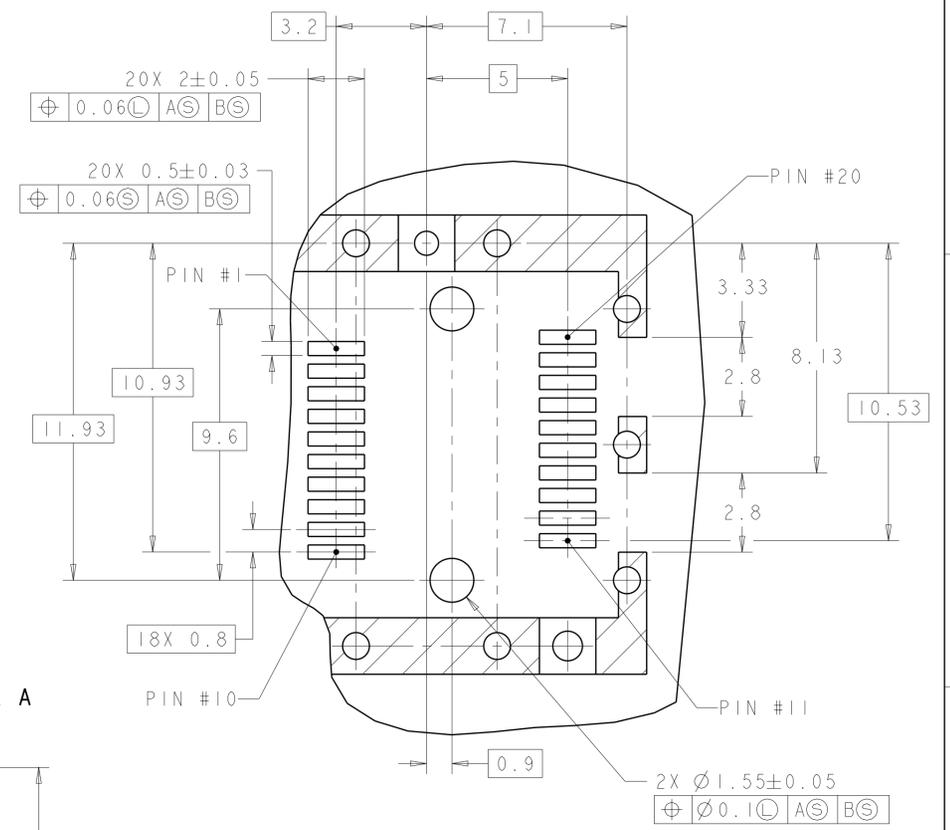
LOC	DIST	REV	DATE	BY	APPD
GP	00				



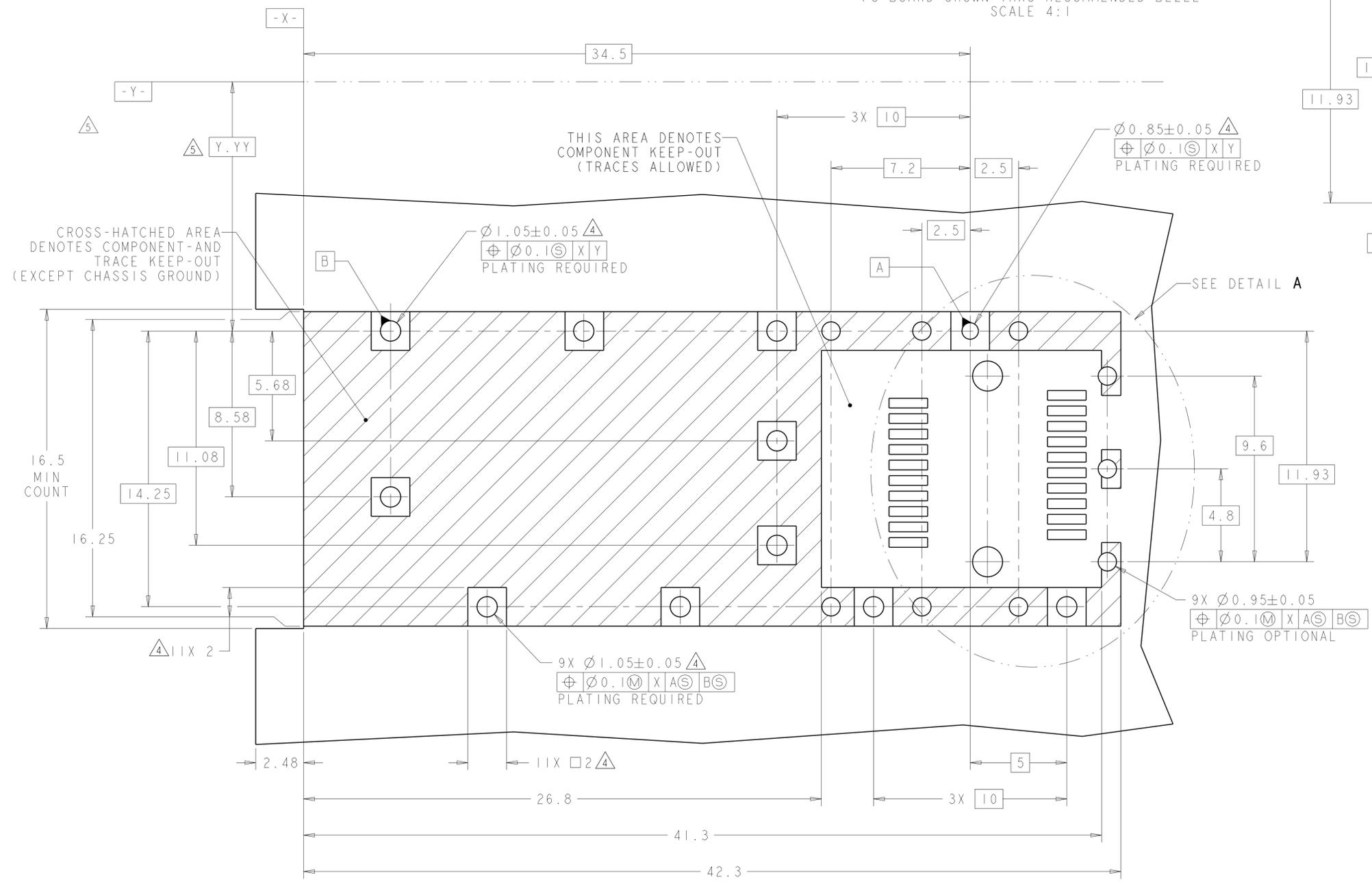
RECOMMENDED BEZEL CUT-OUT  
SCALE 4:1



CAGE ASSEMBLY MOUNTED ON RECOMMENDED  
PC BOARD SHOWN THRU RECOMMENDED BEZEL  
SCALE 4:1



DETAIL A  
SCALE 8:1



RECOMMENDED PCB LAYOUT  
SCALE 8:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN Z. M. BEAM	10JUL2007	 TE Connectivity
DIMENSIONS:		CHK M. R. SCHMITT	10JUL2007	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPD P. H. WERTZ	10JUL2007	
mm		NAME	SFP+ 1X1 CAGE ASSY W/ HEATSINK	
9 PLC ±0.1		PRODUCT SPEC	PCI SOLDER TAILS	
1 PLC ±0.1		APPLICATION SPEC	EXTERNAL EMI SPRING FINGERS	
3 PLC ±0.05		SIZE	108-2364	
4 PLC ±0.05		SIZE	114-13120	
ANGLES ±0.05		WEIGHT	114-13120	
MATERIAL	FINISH	CUSTOMER DRAWING	A100779C=2007193	
SCALE			6:1	
SHEET			2 OF 2	
REV			E	

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9